臺北市都市計畫書

變更臺北市北投區軟橋段88地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區（特）、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案

臺北市政府

中華民國114年12月9日府都規字第11430916831號公告公開展覽

臺北市都市計畫書

變更臺北市北投區軟橋段88地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區（特）、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案

臺北市政府

中華民國114年12月9日府都規字第11430916831號公告公開展覽

目錄

壹、計畫緣起.....1
貳、計畫範圍及發展現況.....4
一、計畫範圍及使用分區.....4
二、北投士林科技園區科技產業專用區開發情形.....5
三、原都市計畫發布情形.....6
四、土地使用現況.....7
五、土地權屬.....9
六、公共設施現況.....10
七、交通運輸現況.....12
參、計畫目標與構想.....14
一、計畫目標.....14
二、計畫構想.....14
肆、變更暨修訂計畫內容.....16
一、土地使用計畫.....16
二、土地使用分區及使用管制.....18
三、都市設計管制要點.....18
伍、事業及財務計畫.....20
陸、其他.....20
附件一、本府同意辦理細部計畫變更函.....21

圖目錄

圖 1 計畫範圍位置示意圖.....4
圖 2 北投士林科技園區科技產業專用區開發情形示意圖.....5
圖 3 土地及建築物使用現況圖.....8
圖 4 計畫範圍土地權屬示意圖.....9
圖 5 周邊公共設施用地示意圖.....11
圖 6 周邊交通系統示意圖.....13
圖 7 變更土地使用分區示意圖.....17
圖 8 指定留設公共開放空間系統示意圖.....19
圖 9 建築基地開發規模管制示意圖.....19

表目錄

表 1 歷年都市計畫發布情形彙整表.....6
表 2 計畫範圍土地權屬表.....9
表 3 變更土地使用分區對照表.....16

案　　名：變更臺北市北投區軟橋段 88 地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區(特)、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案

申請單位：臺北市政府產業發展局

辦理機關：臺北市政府

計畫範圍：詳如計畫圖所示

類　　別：變更

法令依據：都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款

詳細說明：

壹、計畫緣起

北投士林科技園區周邊具備豐沛醫療研究資源與商業機能，本府規劃以「智慧跨域園區」作為發展定位，引進生物技術、數位醫療及資通訊等本市優勢產業及相關新興產業，並結合 AI 等新興技術發展趨勢，推動產業跨域創新與發展。本府並運用科技產業專用區 T16、T17、T18 市有地作為示範基地，促進園區開發及產業進駐。T16 基地設定地上權案於 110 年由金仁寶集團得標，刻正開發中；另 T17、T18 基地設定地上權案前於 110 年由新光人壽得標，然 114 年 5 月 19 日由輝達公司執行長黃仁勳於台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2025）宣布海外總部將落腳北投士林科技園區，並評估於T17、T18作為選址基地。

新光人壽公司前於 114 年 10 月 23 日函文本府表示，考量輝達公司（Nvidia Corporation）來台設立海外總部對國家經濟發展具有重大指標意義，輝達公司進駐北士科亦是該公司及臺北市民之共同願景，提出願與本府協商合意解除契約及相應條件，爰本府與新光人壽協商合意解約，業於 114 年 11 月 24 日完成合意解約協議及塗銷地上權登記、114 年 11 月 28 日完成土地點交事宜。

輝達公司在人工智慧（AI）與加速運算技術領先全球，市值位居世界前三之一（於 114 年 10 月底輝達公司為全球首家市值突破 5 兆美元的公司），且其供應鏈與本市及臺灣產業具備深度合作關係；又本市以「AI Driven Smart City」作為產業與城市發展政策，期以 AI 驅動產業創新與發展智慧城市。輝達公司如能進駐本市設置海外總部，除彰顯臺北及臺灣在全球 AI 產業鏈中的重要地位，更有利於強化本市及國內人工智慧與新興科技產業與全球的連結。爰 T17、T18 基地後續將以專案設定地上權方式，提供輝達公司設立海外總部，期帶動園區上下游相關產業進駐，並將產業發展能量延伸至大內湖科技園區、南港軟體園區及南港生技產業聚落，強化「臺北科技走廊」高科技產業競爭力。

依輝達公司海外總部設立需求，基地面積至少需達 3 公頃以上，而 T17、T18 基地面積分別為 2.29 公頃及 1.60 公頃，兩基地共計 3.89 公頃，然受限於 T17、T18 間道路用地之阻隔，無法滿足用地規模需求；且輝達公司預計海外企業總部擬仿效美國總部之形式，採低量體、高建蔽率方式興建，不符現行建蔽率及都市設計準則相關規定。為使輝達公司順利於本市設立海外總部，並延續北投士林科技園區市有地作為前瞻技術示範基地之功能，故擬合併 T17、T18 基地為 T1718 基地，以擴大基地規模，並配合調整周邊道路路型、建蔽率及相關都市設計準則規定，滿足輝達設立海外總部之用地需求。

鑑於輝達公司居全球 AI 產業領導地位，如能進駐本市設立海外企業總部，除可促進本市科技產業發展、提升產業競爭力，亦將加速本市 AI 產業鏈形成與增益就業機會，為本市滙聚科技產業人才，對於本市整體產業經濟有重要影響。本府雖於近期啟動全市都市計畫通盤檢討相關作業，為及時掌握 AI 產業發展契機，確保本市產業競爭力，倘納入都市計畫通盤檢討案內辦

理恐緩不濟急。故為適應經濟發展之需要，經本府認定本計畫案符合都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款規定辦理都市計畫變更（詳附件一）。

貳、計畫範圍及發展現況

一、計畫範圍及使用分區

本計畫範圍位於北投士林科技園區區段徵收範圍內，由福國路、士科路、軟橋街所圍，為北投區軟橋段 88 地號（T17 基地，科技產業專用區）、93 地號（T18 基地，科技產業專用區）及 89 地號部分土地（道路用地），面積合計約為 42,512.66 平方公尺，緊鄰金仁寶北士科總部大樓、臺北市立中正高級中學、福國社會住宅。

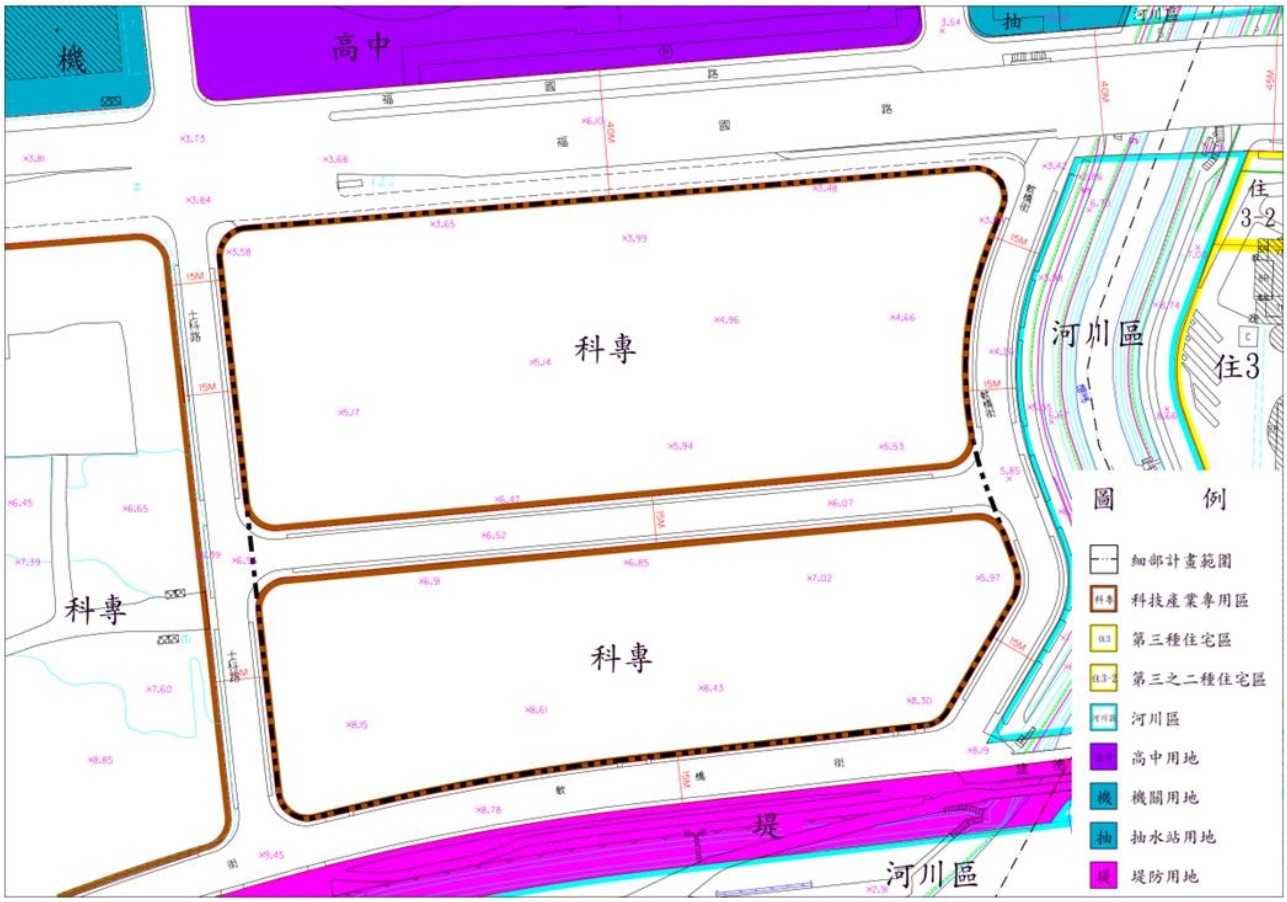


圖 1 計畫範圍位置示意圖

二、北投士林科技園區科技產業專用區開發情形

北投士林科技園區科技產業專用區共計約 24.9 公頃，已開發約為 2.44 公頃，開發中約為 12.07 公頃，未開發（包含都市設計審議核定）約為 10.39 公頃。

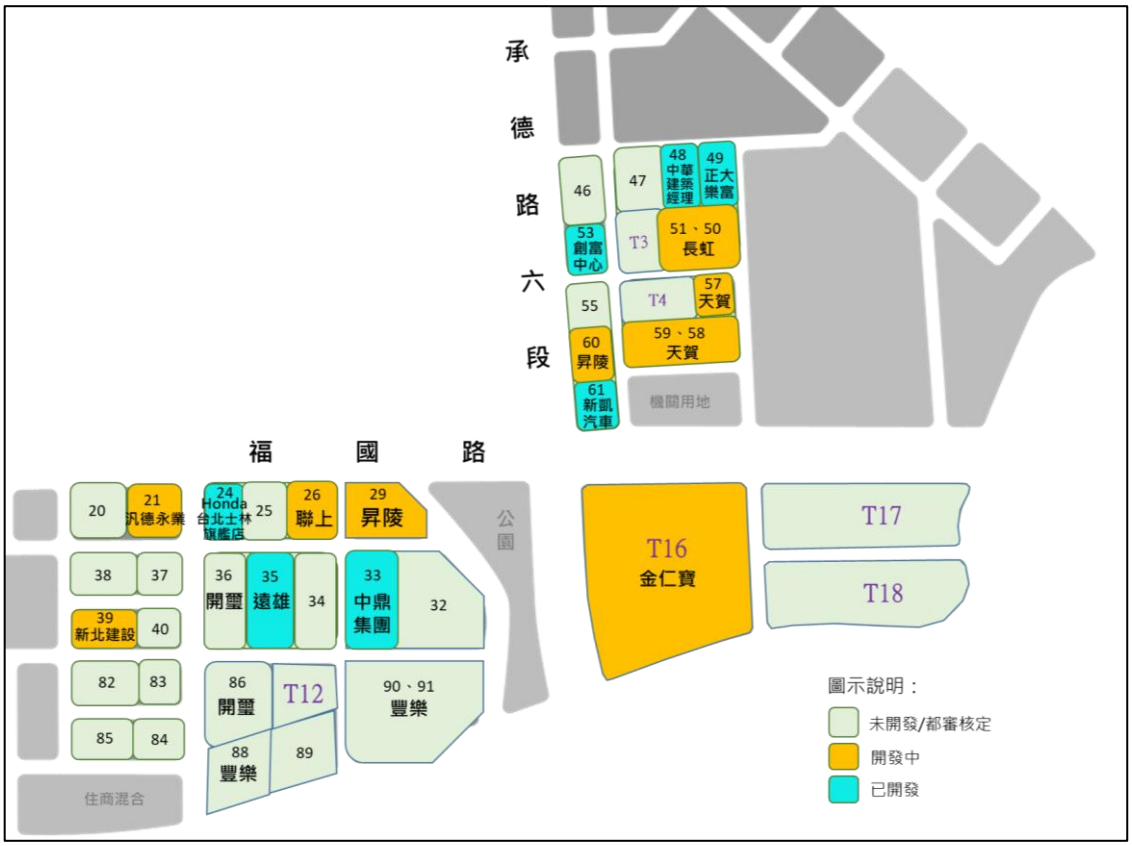


圖 2 北投士林科技園區科技產業專用區開發情形示意圖

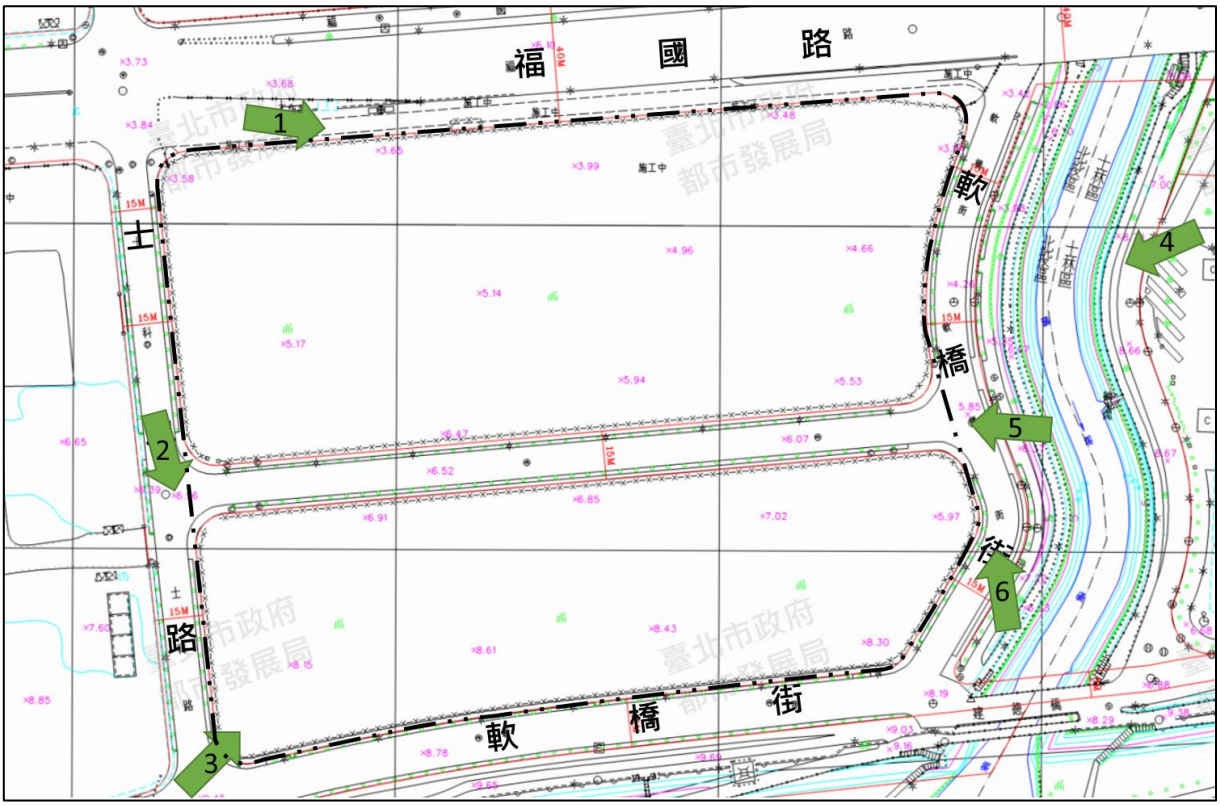
三、原都市計畫發布情形

表 1 歷年都市計畫發布情形彙整表

原都市計畫案名稱	公告日期及文號
為陽明山管理局轄區主要計畫案	59 年 7 月 4 日府工二字第 29248 號
修訂台北市土地使用分區（保護區、農業區除外）計畫（通盤檢討）案	79 年 9 月 13 日府工二字第 79049926 號
變更臺北市基隆河以東、雙溪南北兩側地區主要計畫為北投士林科技園區案（區段徵收範圍）	98 年 7 月 31 日府都規字第 09803478700 號
擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案	99 年 10 月 25 日府都規字第 09902865200 號
修訂「擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案」土地使用分區管制暨都市設計管制要點案	107 年 8 月 15 日府都規字第 10720048791 號
修訂「擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案」土地使用分區管制暨都市設計管制要點案(第二次修訂)	108 年 10 月 9 日府都規字第 10830902671 號
臺北市北投區都市計畫主要計畫(第二次通盤檢討)案(第一階段)	111 年 8 月 4 日府都規字第 11100958801 號
臺北市北投區都市計畫細部計畫(第二次通盤檢討)案(第一階段)	111 年 10 月 7 日府都規字第 11130730551 號
修訂「擬定臺北市北投士林科技園區(區段徵收範圍)細部計畫案」土地使用分區管制案(第三次修訂)	113 年 6 月 6 日府都規字第 11330350141 號
擬定「臺北市開發基地體感降溫專案」細部計畫案	113 年 11 月 12 日府都設字第 11300917561 號

四、土地使用現況

本計畫範圍位於北投士林科技園區區段徵收範圍內，第 2 期公共工程（東基地）於 111 年 10 月 10 日已竣工，現況為空地使用。計畫範圍西側 T16 基地為興建中之金仁寶總部大樓，計畫範圍北側為市立中正高中，東側及南側為磺溪跟外雙溪。



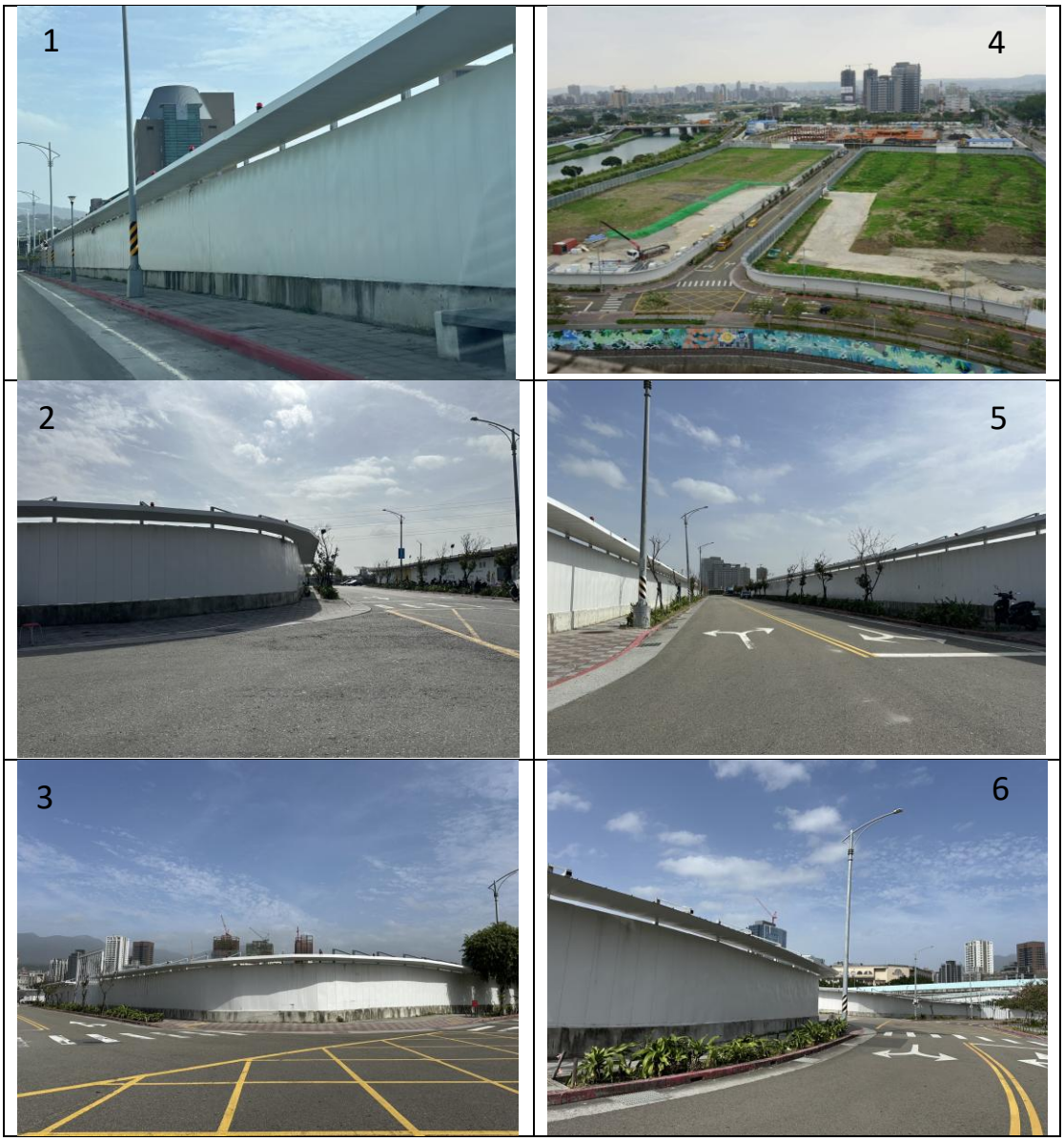


圖 3 土地及建築物使用現況圖

五、土地權屬

本計畫範圍坐落臺北市北投區軟橋段 88、89、93 地號共 3 筆土地，所有權人為臺北市，88、93 地號土地管理機關為臺北市政府地政局土地開發總隊，89 地號土地管理機關為臺北市政府工務局新建工程處（詳表 2 及圖 4）。

表 2 計畫範圍土地權屬表

地段	地號	使用分區	所有權人	管理機關	面積(平方公尺)
北投區軟橋段	88	科技產業專用區	臺北市	臺北市政府地政局土地開發總隊	22,860.53
	89(部分)	道路用地(公共設施用地)	臺北市	臺北市政府工務局新建工程處	3613.26
	93	科技產業專用區	臺北市	臺北市政府地政局土地開發總隊	16,038.87
				總計	42,512.66

備註：面積僅供參考，實際面積應以核定計畫圖實地分割測量面積為準。

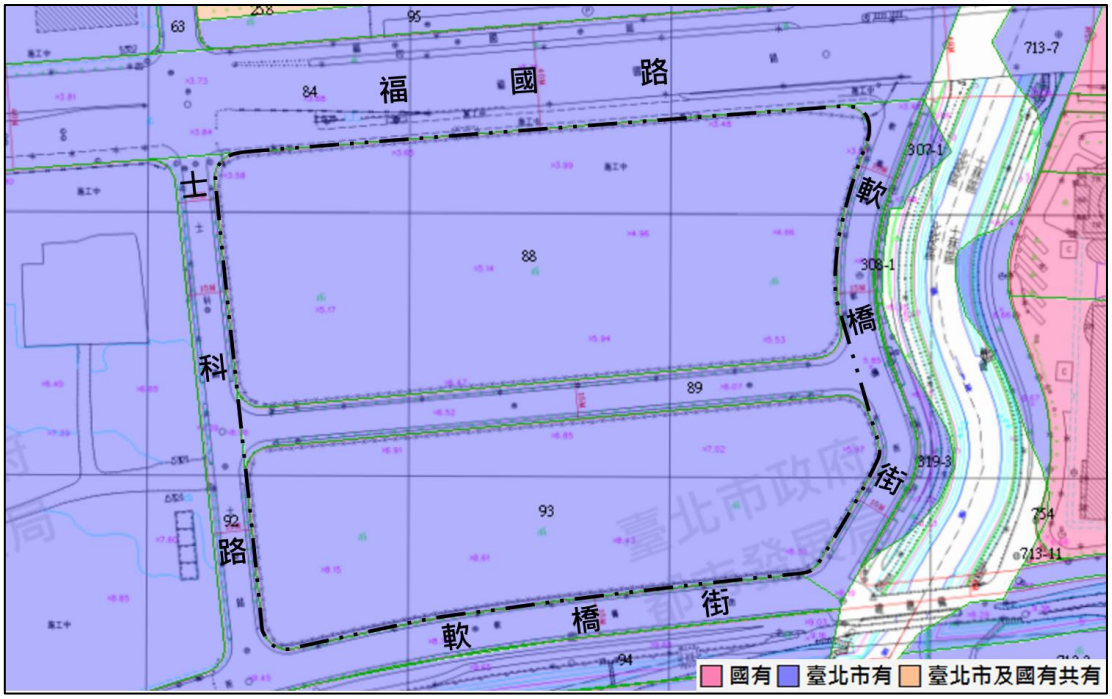


圖 4 計畫範圍土地權屬示意圖

六、公共設施現況

本計畫範圍周邊半徑 500 公尺內公共設施如下（詳圖 5）。

(一) 國小用地

本計畫範圍鄰近文林國小及文昌國小等 2 處國小用地。

(二) 高中用地

本計畫範圍鄰近中正高中 1 處高中用地。

(三) 公園用地

本計畫範圍鄰近軟橋公園、洲美蜆仔港公園、美崙公園、新佳公園等 4 處公園用地。

(四) 機關用地

本計畫範圍鄰近福國社會住宅、臺灣戲曲中心等 2 處機關用地。

(五) 抽水站用地

本計畫範圍鄰近文林抽水站、文昌抽水站等 2 處抽水站用地。

(六) 綠地用地

本計畫範圍鄰近承德路六段兩側綠地用地。

(七) 人行步道用地

本計畫範圍鄰近承德路五段兩側人行步道用地。

(八) 堤防用地

本計畫範圍鄰近外雙溪兩側堤防用地。

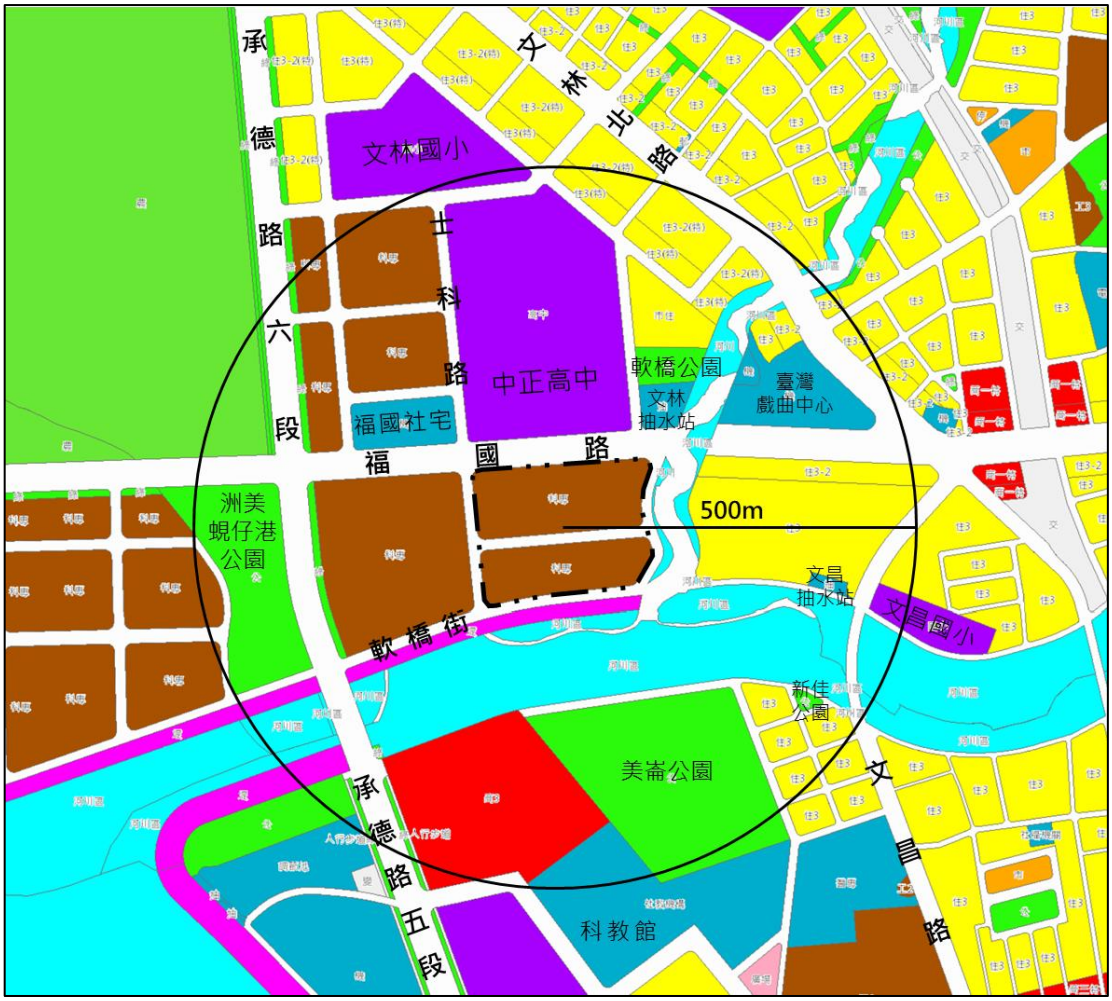


圖 5 周邊公共設施用地示意圖

七、交通運輸現況

(一) 大眾運輸系統

1. 捷運系統

本計畫範圍最近之捷運站為捷運淡水信義線芝山站，另計畫範圍北側福國路目前規劃社子輕軌行經。

2. 公車系統

本計畫範圍周邊為建民里站、創富中心站、福國承信路口站、士科路站、捷運芝山站（戲曲中心）及中正高中站，行經多條公車路線。

3. 公共自行車系統

本計畫範圍周邊設有多處公共自行車租借站(YouBike)提供市民使用。

(二) 道路系統

1. 主要道路

北投士林科技園區聯外主要道路為承德路六段（40 公尺）及文林北路（42 公尺），為主要連接南北之聯外道路，聯絡北投、士林及市中心地區。

園區內主要道路為福國路（40 至 45 公尺），向東連接中山北路五、六段，可通往天母、士林地區及市中心地區，向西連接洲美快速道路，可通往關渡地區及市中心地區。

2. 其他道路

區內道路寬度多為 15 公尺，作為服務園區內之通行。

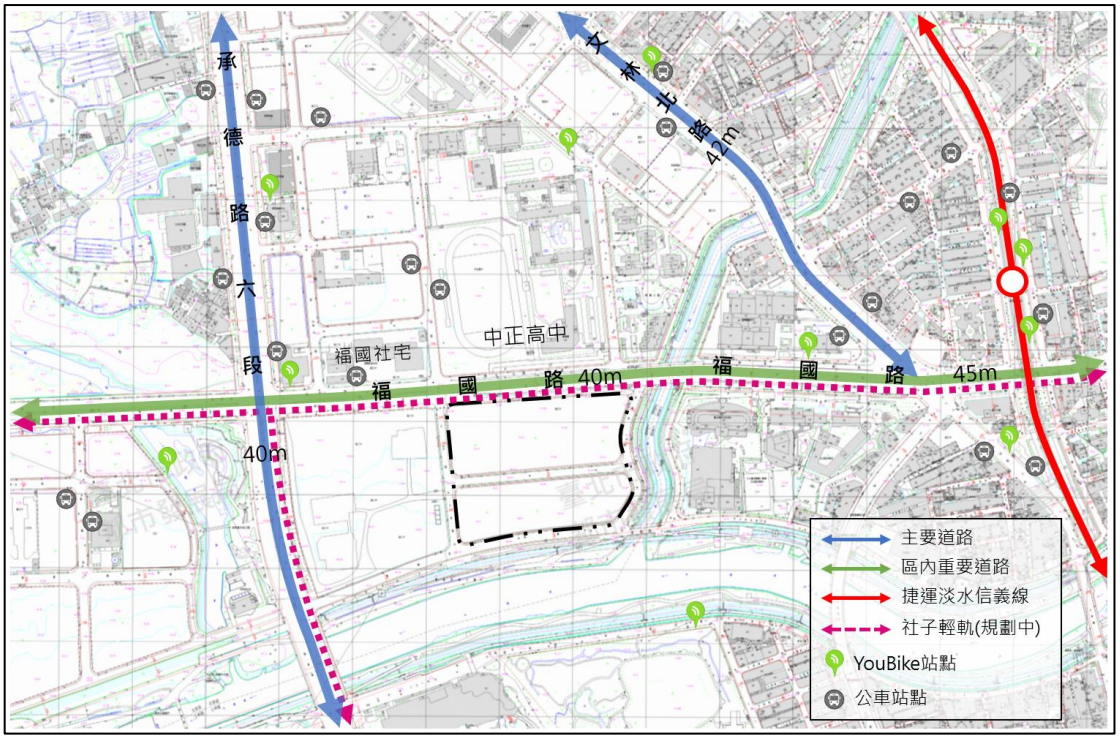


圖 6 周邊交通系統示意圖

參、計畫目標與構想

一、計畫目標

(一) 引進輝達公司投資設立海外總部，延續北投士林科技園區市有地作為前瞻技術示範基地之功能。

(二) 配合輝達公司海外總部建築規劃設計需求，合併 T17、T18 基地並劃設道路用地紓解交通，以及調整相關規定。

二、計畫構想

(一) 合併 T17、T18 為 T1718 基地，並就地區交通系統評估，拓寬 T1718 基地西側、北側之道路用地，併同修訂停車場出入口之規定。

由於輝達公司擇定 T17、T18 基地設立海外總部，為滿足輝達公司用地規模需達 3 公頃以上之需求，爰廢除 T17、T18 間 15 公尺寬道路，合併 T17、T18 為 T1718 同一基地。

就地區交通系統觀之，現行 T16 均以士科路為主要停車場出入口，未來 T1718 基地亦將以士科路進出通往至福國路（主要幹道），且基地北側臨高架橋樑（文林橋）路幅較窄，故於 T1718 基地西側、北側劃設 5 公尺道路用地，將士科路由 15 公尺拓寬至 20 公尺寬、福國路由 40 公尺拓寬至 45 公尺寬，以紓解開發所衍生之交通需求。

此外，原計畫訂有停車場出入口避免以福國路側及臨河岸道路側進出為原則之規定，考量廢除 T17、T18 間 15 公尺寬道路後，如僅得以 T1718 基地西側進出，將使進出交通動線集中至士科路，使士科路有交通壅塞之虞。此外，針對衍生之交通需求將以拓寬道路用地因應，故放寬基地臨路側皆得設置停車場出入口。

(二) 配合輝達公司建築物規劃設計需求，調整土地使用分區管制、都市設計準則等相關規定。

輝達公司海外總部之建築物將採高建蔽率、低量體建築物之形式設計，並仿效美國總部設計為「星艦」之特殊建物造型，採建築物下方內縮，向上向外延伸突出遮簷之設計形式。

為配合輝達公司建築物設計需求，故 T1718 基地法定建蔽率由 50%調整為 70%，並解除建築物最大對角線、最大牆面線之限制。

此外，配合 T1718 基地西側、北側劃設 5 公尺道路用地，並於兼顧特殊建物造型之需求以及開放空間之系統性，將開放空間系統酌予調整為臨路側皆留設 8 公尺帶狀式開放空間，該帶狀式開放空間直上方可設置頂蓋或遮簷，地面層仍應提供人行通行且淨高應大於 4 公尺。另為保留基地地下層彈性規劃，放寬退縮留設開放空間下方得進行開挖。

肆、變更暨修訂計畫內容

一、土地使用計畫

表 3 變更土地使用分區對照表

變更位置	土地使用分區		面積(平方公尺)	變更理由
	原計畫	新計畫		
北投區軟橋段88、93地號	科技產業專用區	道路用地	2,095.69	1. 為引進輝達公司設立海外總部，加速帶動人工智慧與新興科技產業之跨域發展和國際鏈結，以帶動本市高科技產業發展，故配合輝達公司海外總部用地規模需求，合併 T17、T18 為 T1718 基地，並廢除 T17、T18 基地間 15 公尺寬道路。 2. 另就地區交通系統觀之，現行 T16 均以士科路為主要車道出入口，未來 T1718 基地亦將以士科路進出通往至福國路（主要幹道），且基地北側臨高架橋樑（文林橋）路幅較窄，故於 T1718 基地西側、北側劃設 5 公尺道路用地，將士科路由 15 公尺拓寬至 20 公尺寬、福國路由 40 公尺拓寬至 45 公尺寬，以紓解開發所衍生之交通需求。
	科技產業專用區	科技產業專用區（特）	36,803.71	
北投區軟橋段89地號(部分)	道路用地	科技產業專用區（特）	3,499.65	

備註：面積僅供參考，實際形狀、面積大小與位置應依公告實施後之計畫圖實地分割測量為準。

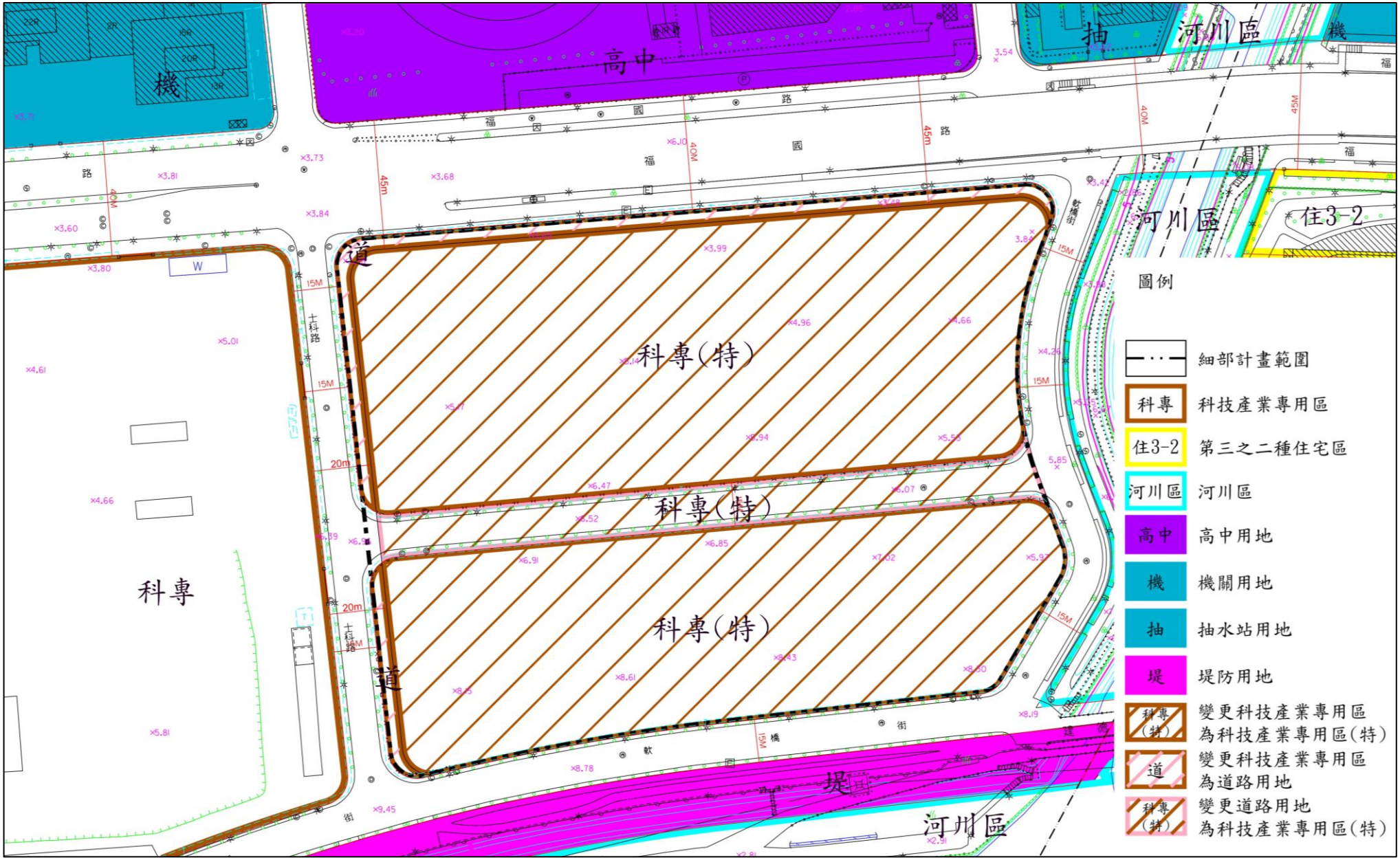


圖 7 變更土地使用分區示意圖

二、土地使用分區及使用管制

本計畫「科技產業專用區（特）」法定建蔽率為 70%、法定容積率為 300%，其餘比照原計畫科技產業專用區規定辦理。

三、都市設計管制要點

本計畫「科技產業專用區（特）」（T1718 基地）除下列各點外，其餘悉依本府 108 年 10 月 9 日府都規字第 10830902671 號公告「修訂『擬定臺北市北投士林科技園區（區段徵收範圍）細部計畫案』土地使用分區管制暨都市設計管制要點案（第二次修訂）」內都市設計管制要點原 T17、T18 及科技產業專用區之規定辦理。

(一) 臨路側應退縮留設 8 公尺寬帶狀式開放空間（如圖 8），該帶狀式開放空間直上方得設置頂蓋或遮簷，地面層仍應提供人行通行且淨高應大於 4 公尺，不受前揭都市設計管制要點「一、（一）附圖一」指定留設公共開放空間系統之限制。。

(二) 退縮留設之開放空間下方得進行開挖，不受前揭都市設計管制要點「八、(五)」開放空間下方不開挖之限制。

(三) 建築物不受前揭都市設計管制要點「二、(一) 2.」建築物最大對角線及最大連續牆面線之限制。

(四) 臨道路側均得設置停車場出入口，不受前揭都市設計管制要點「四、(三)」停車場出入口設置之限制。

(五) T1718 基地應以全街廓開發（如圖 9）。

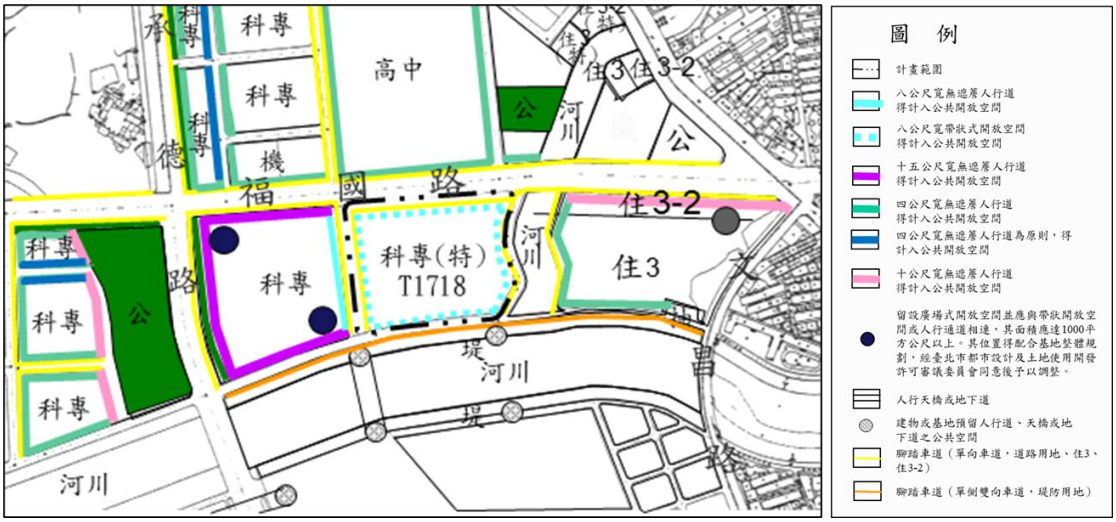


圖 8 指定留設公共開放空間系統示意圖

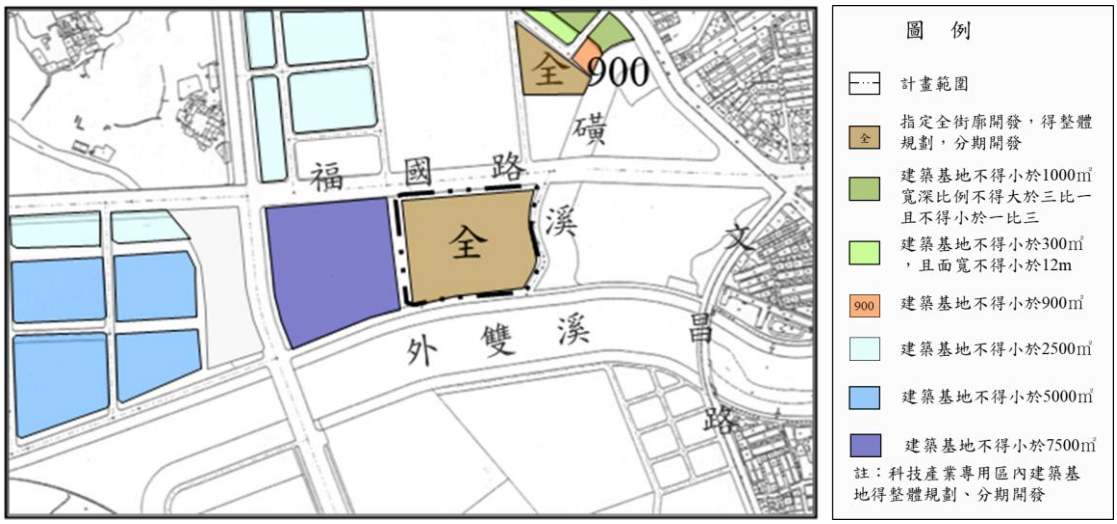


圖 9 建築基地開發規模管制示意圖

伍、事業及財務計畫

一、本計畫範圍科技產業專用區（特），未來以專案設定地上權或其他開發方式辦理，並預計於 115 年辦理相關作業。

二、T17、T18 基地間原 15 公尺寬計畫道路廢除並於士科路、福國路側新劃設 5 公尺道路用地，由科技產業專用區（特）之開發權利人負責興闢及費用。

陸、其他

一、本案擬以專案設定地上權方式開發，因道路用地屬區段徵收無償取得之公共設施用地，T17、T18 基地間 15 公尺寬計畫道路廢除由道路用地變更科技產業專用區（特）之面積為 3,499.65 平方公尺，配合增劃之道路用地為 2,095.69 平方公尺，故本案道路用地減少面積（1403.96 平方公尺）之所得價款，將作為增添該區段徵收範圍內公共設施建設費用。另增劃之道路用地佔變更減少之道路用地比例約為 59.88%（2,095.69／3,499.65），符合公共設施用地變更為工業區應回饋 16%土地（3499.65*16%=559.94 平方公尺）之本市公共設施用地檢討原則。

二、本計畫未規定事項，悉依原計畫及科技產業專用區規定辦理，餘依臺北市土地使用分區管制自治條例暨相關法令規定辦理。

附件一、本府同意辦理細部計畫變更函

檔　　號:
保存年限:

臺北市政府　函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：藍浩君
電話：1999分機6584
電子信箱：bd2403@gov.taipei

受文者：臺北市政府都市發展局

發文日期：中華民國114年11月19日
發文字號：府授產業科字第1143036890號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴局辦理「北投區軟橋段88、93地號土地（T17、T18街廓）專案設定地上權案」細部計畫變更，經核符合「都市計畫法」第27條第1項第3款規定，請查照。

說明：

一、貴局案陳旨揭土地擬依本府114年9月30日府法綜字第1143044819號令修正「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，辦理專案設定地上權予輝達公司設立其海外企業總部，惟依據輝達公司所需基地面積，以及建物採低量體、高建蔽率方式之興建需求等，須透過細部計畫變更，廢除移設T17、T18街廓間道路用地、調整合併後之基地建蔽率，並配合調整都市設計準則及相關規定，方能滿足輝達公司之興建需求。

二、本府雖於近期啟動全市都市計畫通盤檢討相關作業，惟鑑於輝達公司居全球AI產業領導地位，如能進駐本市設置海外企業總部，可彰顯臺北及臺灣在全球AI產業鏈之關鍵角色，有利於加速帶動人工智慧與新興科技產業之跨域發展和國際鏈結，對於本市整體產業經濟有重要影響；爰為及

都市發展局 1141119
BCAA1143087095

時掌握AI產業發展契機，確保本市產業競爭力，倘納入通盤檢討案內辦理恐緩不濟急，確屬為適應經濟發展需要時之情形，具迅行變更都市計畫之急迫性及必要性，經核符合旨揭條款規定。

正本：臺北市政府產業發展局
副本：臺北市政府都市發展局 電子公文交換章 2026/1/19 14:41:23

臺北市政府 都市發展局	繪圖員
業務主管	
承辦人員	校對者